

MiniLab-S125A multi-cathode sputtering system

MiniLab-S125A【多元マルチスパッタ装置】(～Φ8inch基板対応)

【6元マルチスパッタ装置(～Φ4inch用)】

【4元マルチスパッタ装置(～Φ6inch、Φ8inch用)】

コンパクトサイズ(1,767 x 754mm)システムフレームに、カソード最大4源、又は6源搭載、マルチスパッタ装置。

●連続多層膜、同時成膜(2～6源同時成膜)、又、抵抗加熱蒸着・有機材料蒸着・EB蒸着・PECVDなどの混在仕様も構成可能です。



Load Lock チャンバー

- RIEプラズマエッチングステージ
メインチャンバー, LL室いづれも可能
- ・RF150W, 300W, 又はDC850W
- ・<30W低出力制御ソフトエッチング



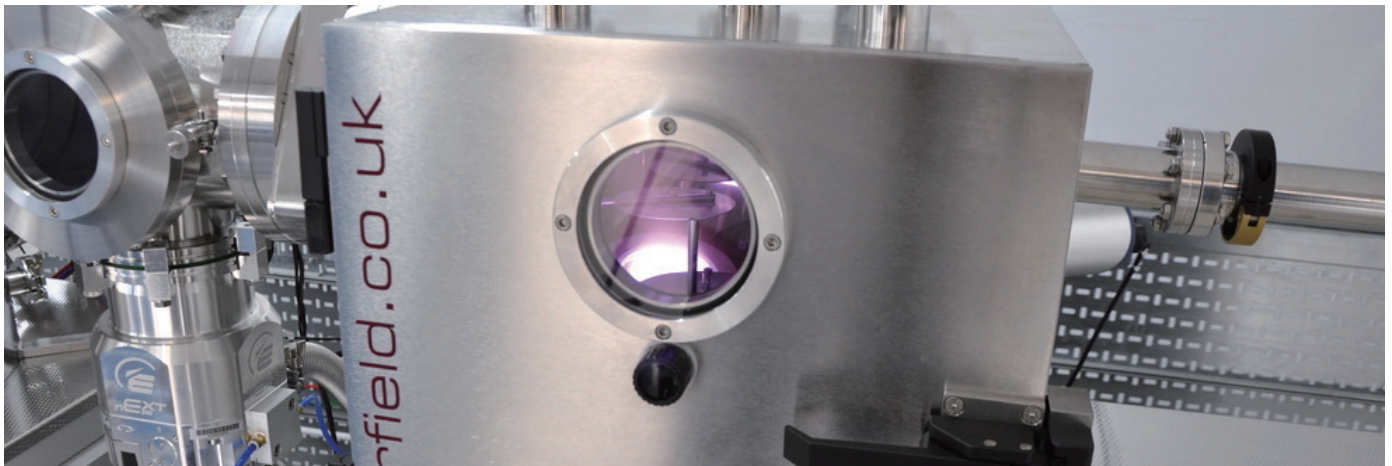
MiniLab-S060A スパッタリング装置

- Φ2inchカソード x 4源(DC, RF兼用)
- 4源同時スパッタ

MiniLab-S125A 多元マルチスパッタリング装置

寸法:1,767(W) x 754(D) x 1,645(H)mm

装置構成事例③



MiniLab-S125A スパッタリング装置

【チャンバー仕様】

- 500(W) x 500(D) x 650(H)
- SUS304フロントローディング式
- Φ90mmビューポート x 1
- 到達真空度 5x10⁻⁵ Pascal

【基板ステージ】

- Φ1inch~Φ11inch基板対応
- 基板回転(回転速度30段階速度可変式)
- 基板加熱ヒーター
500℃ハロゲンランプヒーター
800℃C/Cコンポジット、又はSiCコーティング

【マグネトロンスパッタリング】

- Φ2inchマグネトロンカソード x 最大6源
- Φ3inchカソードの場合 x 最大4源
- 磁性材料用高強度マグネット(オプション)
- 水冷式、傾斜フレキシブルアングルヘッド

【スパッタ電源】

- RF150W, 300W, 又はDC850W
- HiPIMS電源(PulseDC 5KW)も併設可能

* プラズマリレー SW で HMI 画面より自在に 6 カソードへの電源分配・配置設定の変更が可能

RIEプラズマエッチングステージ

- RF150W, 300W, 又はDC850W
- <30W低出力制御ソフトエッチング
*メインチャンバ, LLチャンバ共搭載可能です。

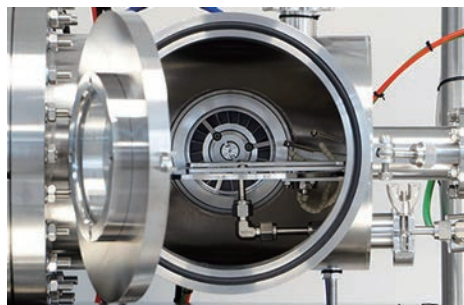
その他仕様

- MFCガス x 最大3系統(Ar, O2, N2)
- APC自動圧力制御
- 真空ポンプ:TMP +ロータリー(又はドライスクロール)
- ワイドレンジ真空計(キャパシタンスマノメータ オプション)
- 基板シャッター、ソースシャッター
- 水晶振動子膜厚センサー
- SQC-310, SQM-160薄膜コントローラー(オプション)

Windows-PC で一元管理：バルブ操作・成膜操作（ソース ONOFF・シャッター開閉・回転等）、真空 / パージ等全ての装置操作を PC インターフェイス 1 箇所で行いますので、操作が分散しません。



スパッタリングカソード

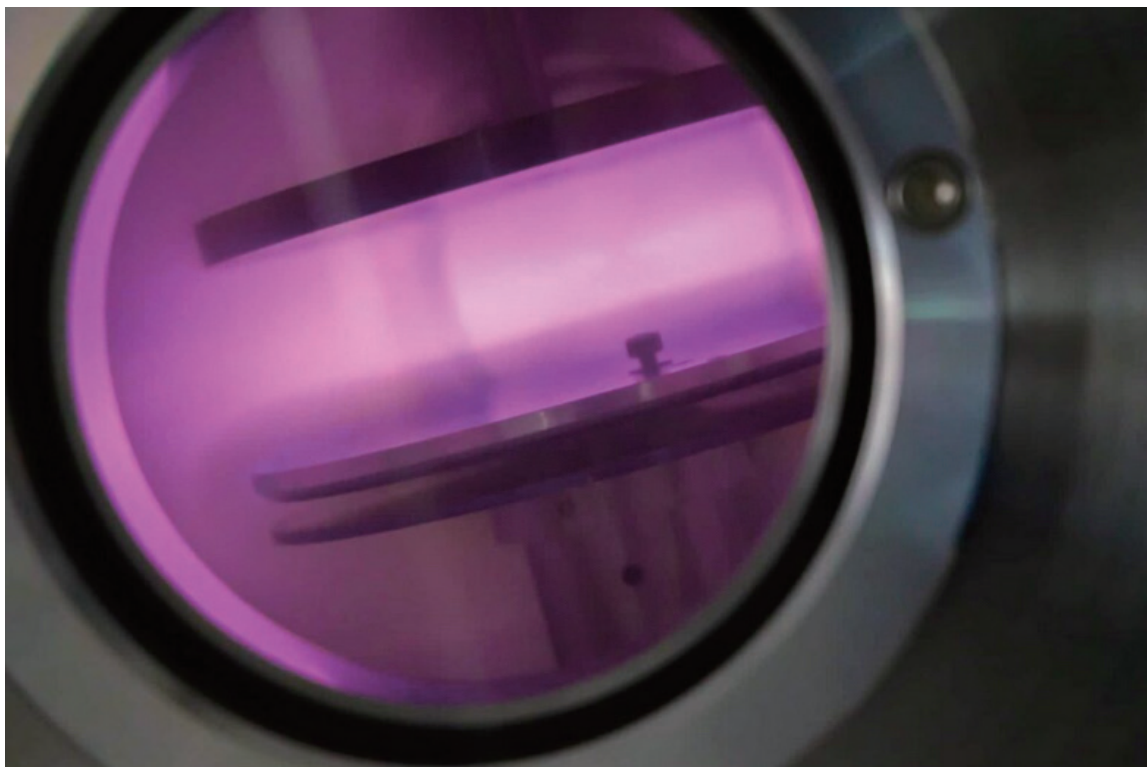


ロードロック搬送機構



基板加熱ヒーター(SiCコート)

装置構成事例③



RIEプラズマエッチングステージ(メインチャンバー, LL室いずれも可能)

- ・RF150W, 300W, 又はDC850W
- ・<30W低出力制御ソフトエッチング

装置外形寸法

